

Press Release

2023年3月17日

※本プレスリリースは、[2023年1月16日にドイツ・ヘンケル本社が発表したプレスリリース](#)の日本語訳版です。本プレスリリースは英語が原本であり、その内容・解釈については英文プレスリリースが優先します。

電子部品の組立用途に最適な室温硬化型ギャップフィラー
ヘンケル、新しいギャップフィラー

BERGQUIST GAP FILLER TGF 2900LVOを発売： 設計に更なる自由度を

デュッセルドルフ - 現代の車は先端エレクトロニクスへの依存度を増しており、メーカーは制御モジュールなどの主要車載電子部品を効率よく経済的に組み立てられる信頼性の高いソリューションを必要としています。ヘンケルの接着技術事業部門は自動車OEMや部品メーカーのパートナーとして、この需要を満たすために先進材料のポートフォリオの拡大を図っています。今回発売するのは、幅広い電子部品組立用途に最適化された新たな液状サーマルギャップフィラーです。

BERGQUIST(パークイスト)GAP FILLER(ギャップフィラー)TGF 2900LVOは、広範な電子部品の組立に適したシリコン樹脂系2液性室温硬化型ギャップフィラーです。BERGQUIST GAP FILLER TGF 2900LVOは低揮発ガス特性を有しており、シロキサンガスの発生が問題となる用途に最適です。

塗布ラインの厚みを極薄にできるため、困難な条件での放熱や熱移動を最適化できる汎用的で優れたソリューションとなります。BERGQUIST GAP FILLER TGF 2900LVOは、ショットの安定性の高い塗布が容易であり、高スループット生産に非常に適しています。

ヘンケル製品開発部長のBart Van Eeghemは、「ヘンケルの新世代ギャップフィラーとなるTGF 2900LVOは、自動車制御モジュールでの最適解となる優れた性能を示します。TGF 2900LVOが極薄の塗布ラインを可能にしたことで絶えず進化しているモジュール設計において多様なソリューションを見つけ出すことができ、同時にシステムの全体的な熱抵抗率を下げることができます。」「今回のヘンケル新製品はお客様のニーズにしっかりと応えます。その汎用性と可使用時間の長さから、サプライチェーンの複雑さが緩和され、プロセスの加工性と柔軟性も向上します」と説明しています。

ヘンケル熱マネジメントソリューションの詳細は、www.henkel-adhesives.com/de/en/products/thermal-management-materials.htmlより閲覧いただけます。

ヘンケルについて

ヘンケルはブランド、イノベーション、テクノロジーにより、産業およびコンシューマー向け事業において世界中の市場をリードしています。アドヒーズブテクノロジー(接着技術)事業部門は接着剤、シーリング剤、機能性コーティング剤市場のグローバルリーダーとなっています。コンシューマーブランド事業部門は特にヘアケアやランドリー&ホームケアの分野において、世界中の市場やカテゴリーをリードする地位を維持しています。ヘンケルには3つの強力なブランド、LOCTITE(ロックタイト)、Persil(パーシル)、Schwarzkopf(シュワルツコフ)があります。2022年度の売上高は220億ユーロを超え、営業利益はおおよそ23億ユーロでした。ヘンケルの優先株は、ドイツ株式指数DAXのリストに入っております。ヘンケルには長いサステナビリティの歴史があり、具体的な目標を掲げた明確なサステナビリティ戦略を推し進めます。1876年に創業したヘンケルは現在、世界に50,000名以上の社員を擁し、多様なチームが強固な企業文化、共通の価値観とヘンケルの社員をひとつにまとめる共通基盤である企業目的「Pioneers at heart for the good of generations」の元に結束しています。さらなる情報はこちらwww.henkel.comをご覧ください。

ヘンケルジャパンウェブサイト: www.henkel.co.jp

ヘンケルジャパン接着技術事業部門ウェブサイト: www.henkel-adhesives.com/jp

ヘンケルジャパンFacebook: www.facebook.com/HenkelJapan

ヘンケルジャパン接着技術事業部門YouTube: www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies

— 本件に関するお問合せ先 —
ヘンケルジャパン株式会社 オートモーティブコンポーネンツ事業部
青木 雪絵

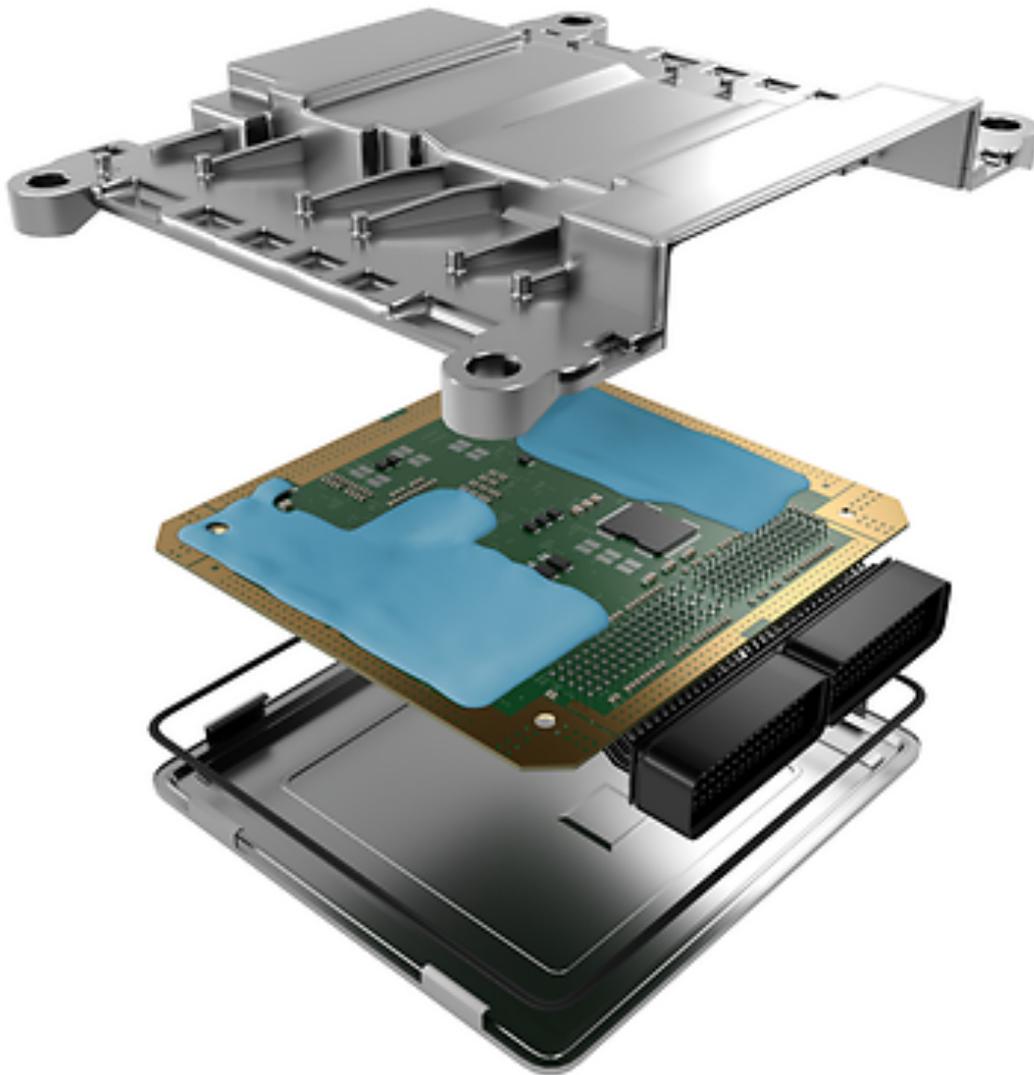
LOCTITE TECHNOMELT BONDERITE ZEROSPON AQUENCE Ceresit Pattex Pritt

— 本件に関する報道担当 —

Vincent Zimmermann

e-mail: Henkel.adhesive-technologies@emanatepr.com

写真資料は、www.henkel.com/press-and-mediaより入手いただけます。



BERGQUIST GAP FILLER TGF 2900LVOは、幅広い電子部品組立用途に最適化されており、シロキサンガスが問題となる用途に最適です。